

版数 REV.	年月日 DATE	CON NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
6	7.Aug.2009	068420	Added New Items etc	---	K.ASHIBU	T.NEMOTO	A.NATORI
7	14.Apr.2010	069719	Added New Items etc	---	K.ASHIBU	T.NEMOTO	A.NATORI
8	25.May.2010	069988	Added New Items	---	K.ASHIBU	T.NEMOTO	A.NATORI

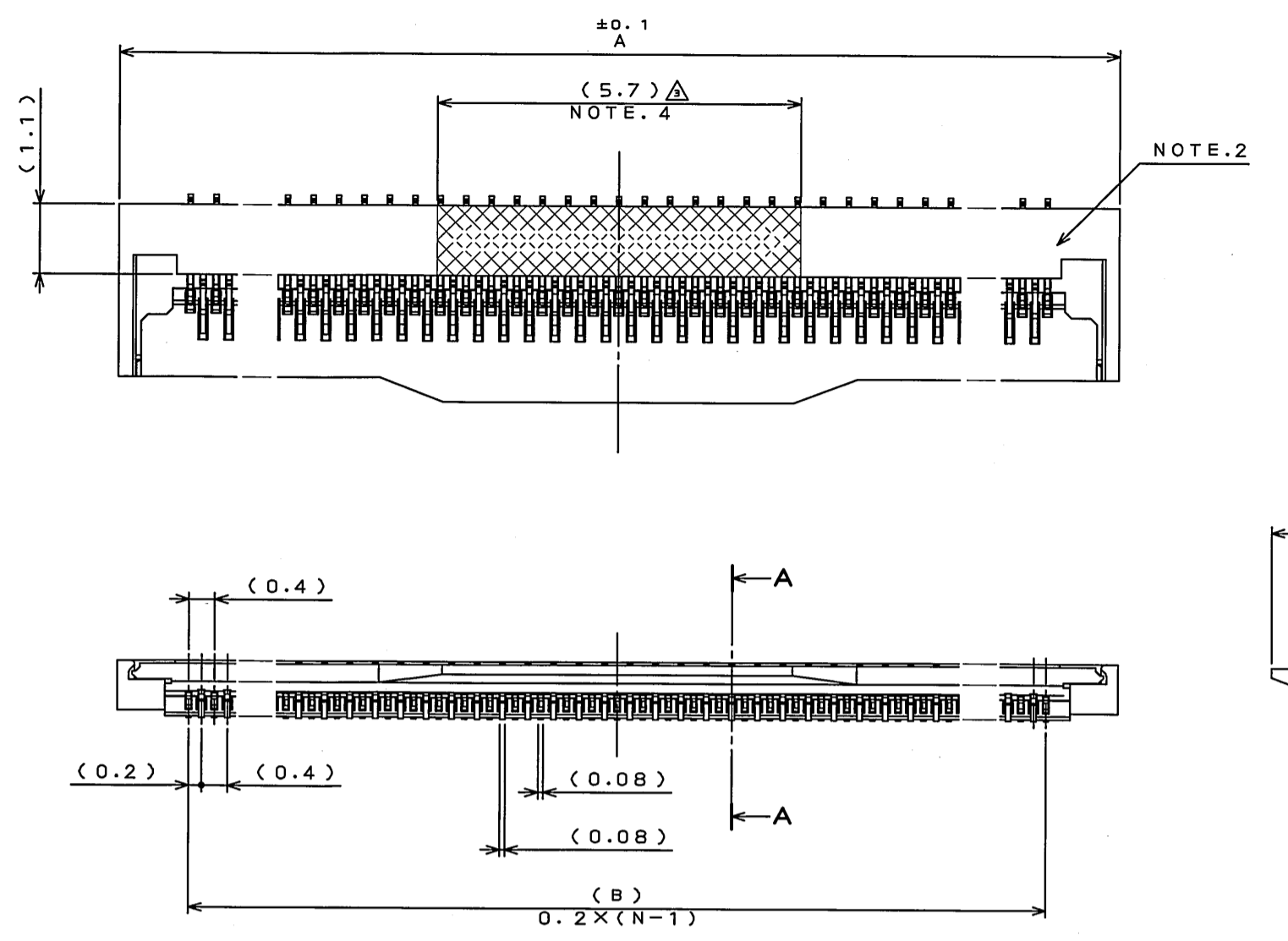
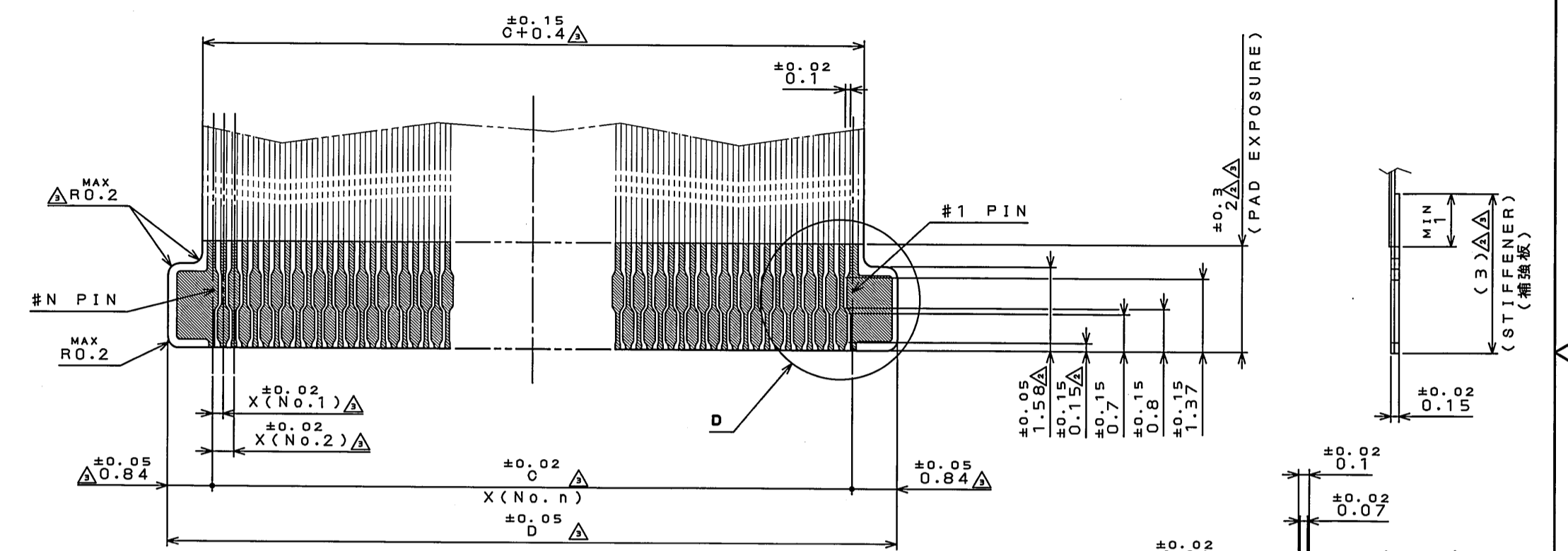
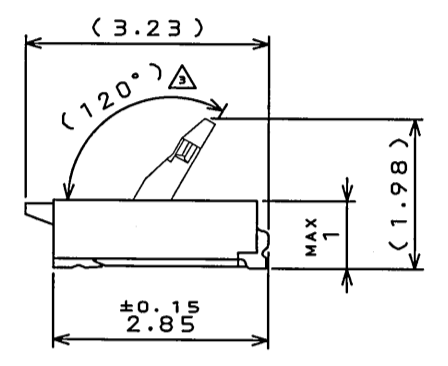
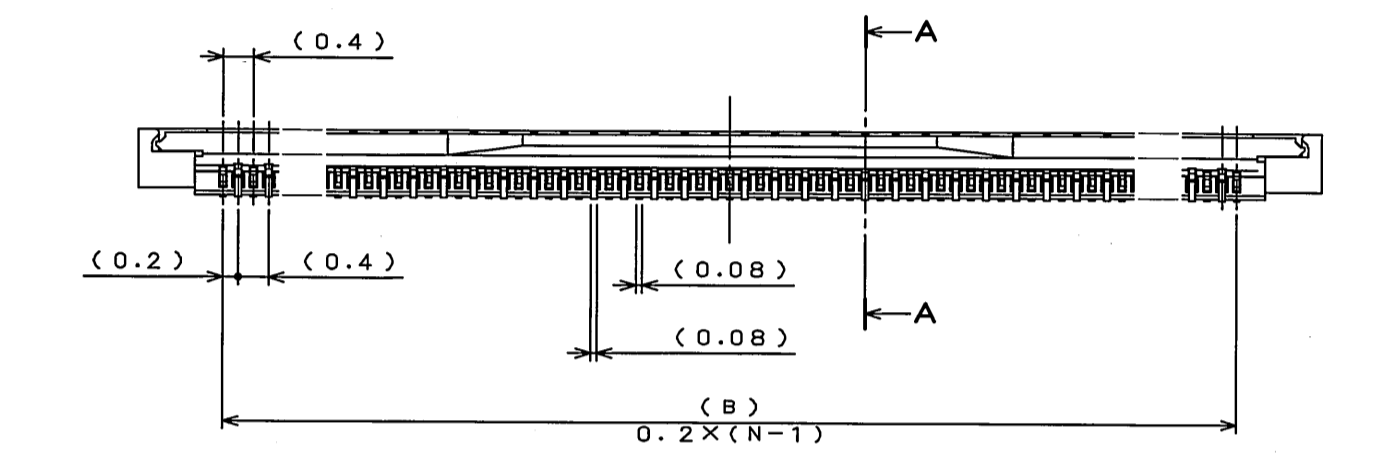
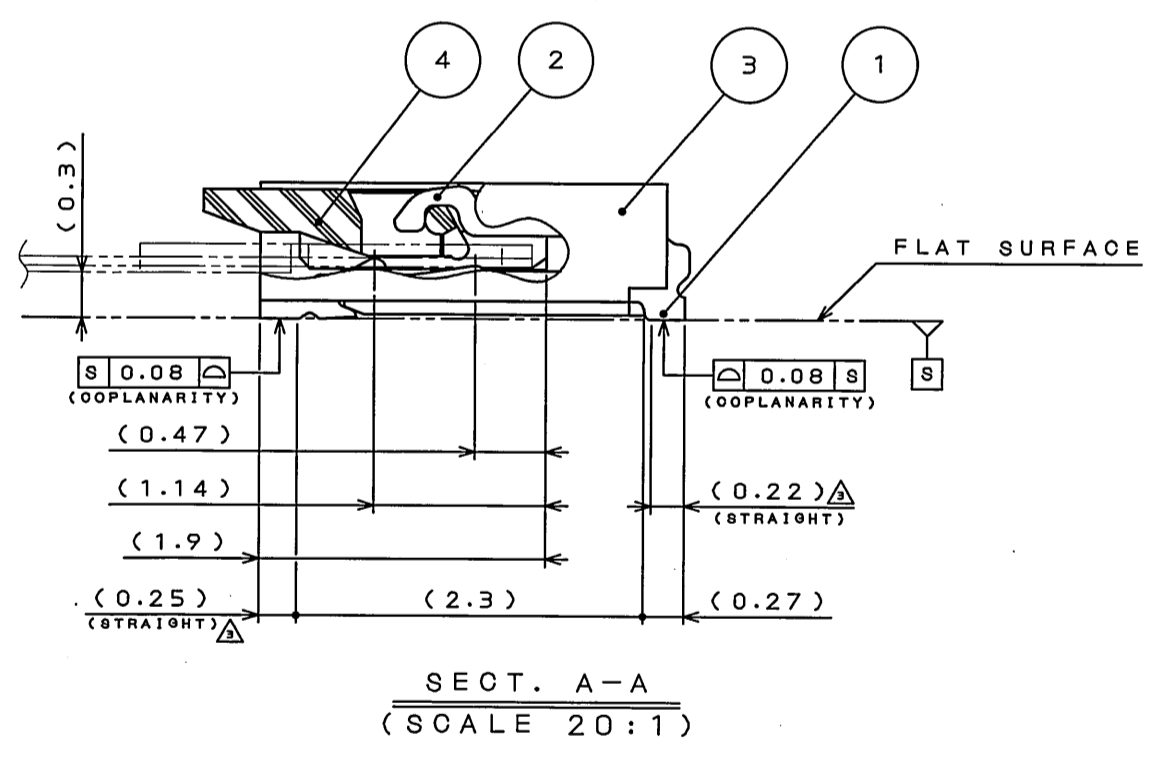


TABLE 3. DIMENSIONS

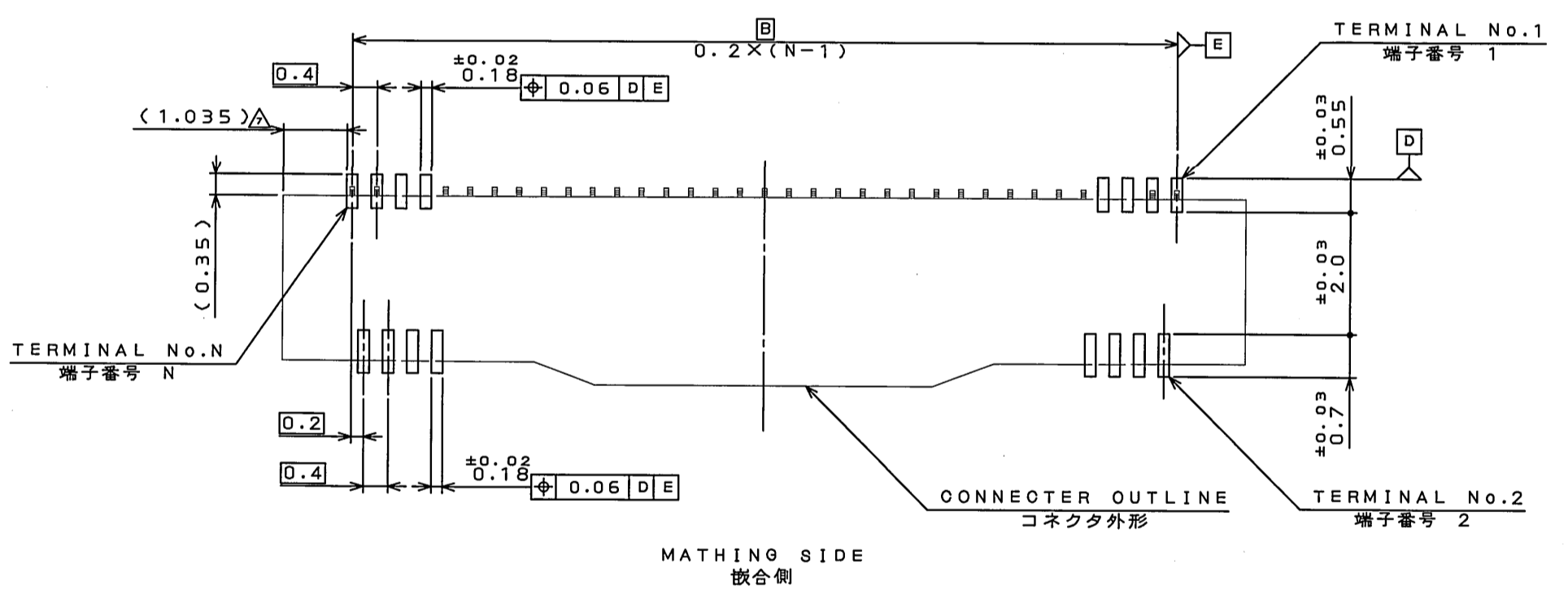
NO.	X
1	0.2
2	0.4
3	0.6
.	.
.	.
n	0.2 X (n-1)



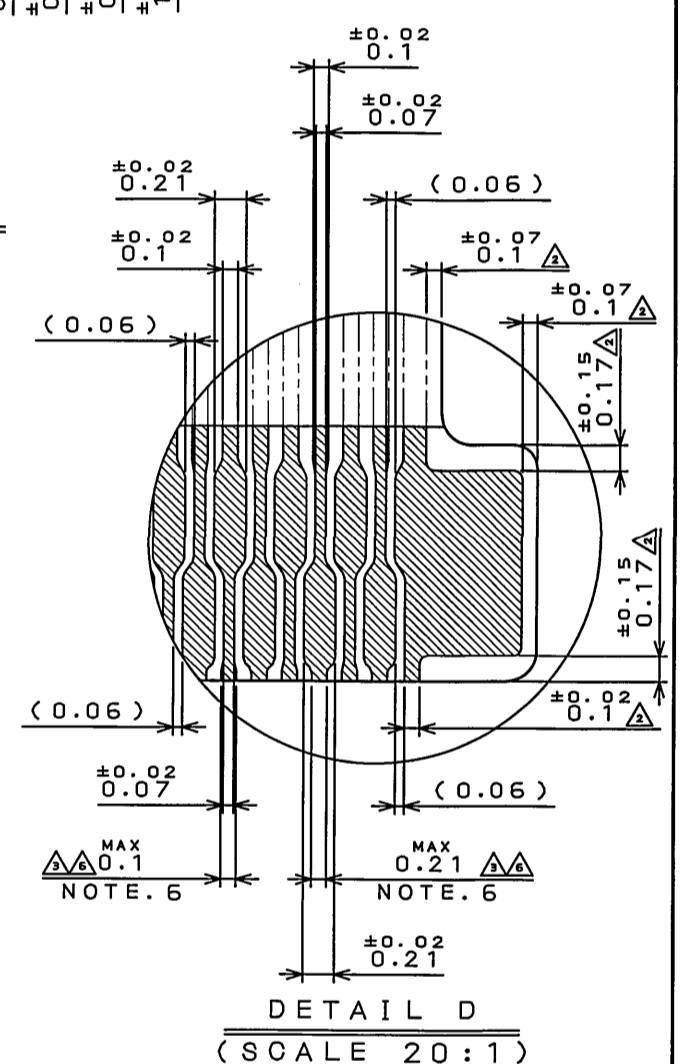
APPLICABLE F.P.C. DIMENSION (REF.)
適合FPC寸法(参考)



SECT. A-A
(SCALE 20:1)



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法(参考)



DETAIL D
(SCALE 20:1)

NOTE
1. REFER TO TABLE 2 FOR RECOMMENDED FPC COMPOSITION.
2. LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP PORTION OF THE CONNECTOR.
3. A NICKEL BARRIER EXISTS BETWEEN EACH CONTACT POINT AND TAIL.
4. THE DIMENSIONS OF VACUUMING COVER AREA.
5. COVERLAY EDGE INCLUDES A PROJECTION OF AN ADHESION LAYER.
6. DIMENSION OF TIP IS OPTIONAL WITHIN ABOVE RANGE WITHOUT PATTERN PEELING.

注記
1.推奨FPC構成はTABLE2参照のこと。
2.ロット番号がコネクタ上面に記載される。
3.各コンタクト接点とSMT部の間にはニッケルバリヤ有り。
4.吸着エリアを示す。
5.カバーレイ端面は接着層のみ出しを含む。
6.先端部寸法は上記寸法範囲内で任意とし、パターン剥れ無き事。

TABLE 2. RECOMMENDED FPC COMPOSITION

COMPOSITION 層名		RECOMMENDED 推奨
GOLD PLATING 金めっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき	0.1 μm MIN
COPPER 銅箔	ROLLED MATERIAL 圧延銅	NOMINAL 18 μm MAX
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	—
BASE FILM ベースフィルム	POLYIMIDE ポリイミド	25 μm
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	30 μm MAX
REINFORCE PLATE 補強板	POLYIMIDE ポリイミド	—

TABLE 1. DIMENSIONS

PRODUCT NO.	A	B	C	D
FF0825SA1	7.05	4.80	4.80	6.48
FF0829SA1	7.85	5.60	5.60	7.28
FF0841SA1	10.25	8.00	8.00	9.68
FF0851SA1	12.25	10.00	10.00	11.68
FF0871SA1	16.25	14.00	14.00	15.68
FF0881SA1	18.25	16.00	16.00	17.68

仕番書 (SPECIFICATION)	数量 (QTY.)	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	備考 (REMARKS)
4 ACTUATOR アクチュエータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック	---	COLOR:BLACK/色相:黒色 UL94V-0
3 BASE INSULATOR ベースインシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック	---	COLOR:BEIGE/色相:肌色 UL94V-0
2 CONTACT 2 コンタクト2	(N-1) 2	COPPER ALLOY 銅合金	PARTIAL GOLD(0.1μm MIN)OVER NICKEL ニッケル上部分Au 0.1μm以上	---
1 CONTACT 1 コンタクト1	(N+1) 2	COPPER ALLOY 銅合金	PARTIAL GOLD(0.1μm MIN)OVER NICKEL ニッケル上部分Au 0.1μm以上	---
符号 NO. DESCRIPTION	個数	材 料	仕 上	備 考
仕番書 (SPECIFICATION) JAOS-10532- J AHL-10532	第1版 (ORIGINAL DATE) 16.Jul.2008	製図 DR. ---	尺度 (SCALE) 10:1	シリーズ (SERIES) FF08
公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR. ---	担当 CHK. K.ASHIBU	名称 (TITLE) FF08**SA1	
寸法 (DIMENSION) - ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±	角度 (ANGLES) ° ± °X' ±	査閲 APPD. K.IINOUE	図面番号 (DRAWING NO.) SJ108178	
		承認 APPD. Y.MIZUSAWA	数量 (MASS) ---	
				日本航空電子工業株式会社 JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
				版数 (REV.) 8